|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACIÓN GENERAL** | | | |
| **Nombre:** |  | | |
| **Fecha:** | DD/MM/AAAA | **Celular:** |  |
| **Servicio** | | | |
| Diseño de tarjetas de circuito impreso | |  | |
| Fabricación de tarjetas de circuito impreso  Impresión de piezas 3D  Diseño de piezas 3D  Transferencia de conocimientos y/o tecnologías  Montaje de componentes electrónicos  Fabricación o integración de soluciones tecnológicas | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **ASPECTOS A EVALUAR** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| **1** | **Diseño de tarjetas de circuito impreso** |  |  |  |
| 1.1 | Requiere normas especiales de diseño (MIL, UL, IPC) |  |  |  |
| 1.2 | Requiere análisis térmico |  |  |  |
| 1.3 | Requiere análisis mecánico |  |  |  |
| 1.4 | Requiere análisis de radio frecuencia |  |  |  |
| **2** | **Fabricación de tarjetas de circuito impreso** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| 2.1 | El equipo se encuentra disponible para el desarrollo del proceso |  |  |  |
| 2.2 | Es menor o igual al máximo tamaño permitido (280mm x 210mm) |  |  |  |
| 2.3 | Se puede fabricar en material FR4 de 1 o 2 caras calibre 1.5 mm |  |  |  |
| 2.4 | Las perforaciones son menores o iguales a (0.4mm) |  |  |  |
| 2.5 | El ancho de las pistas es menor o igual a 0.2 mm |  |  |  |
| 2.6 | El espacio entre pistas, vías y pads es mayor o igual a 0.1mm |  |  |  |
| 2.7 | Acabado Anti-solder color verde |  |  |  |
| 2.8 | Acabado silk-screen color blanco |  |  |  |
| 2.9 | Hueco metalizado |  |  |  |
| **3** | **Fabricación o integración de soluciones tecnológicas** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| 3.1 | Requiere cumplimiento de normas especiales de productos electrónicos (IPC clase 2 o 3) |  |  |  |
| 3.2 | Se cuenta con los equipos o herramientas necesarias |  |  |  |
| **4** | **Transferencia de conocimientos y/o tecnologías** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| 4.1 | Se cuenta con los equipos o herramientas necesarias |  |  |  |
| 4.2 | Se cuenta con los materiales necesarios para realizar la transferencia |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **5** | **Diseño de piezas en 3D** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| 5.1 | El software de diseño se encuentra autorizado para uso institucional |  |  |  |
| 5.2 | El diseño debe cumplir con medidas exactas para ensamblaje |  |  |  |
| **6** | **Impresión de piezas en 3D.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| 6.1 | La impresora se encuentra disponible para el desarrollo del proceso |  |  |  |
| 6.2 | El software del equipo está actualizado para la fabricación |  |  |  |
| 6.3 | Los materiales de impresión solicitados están disponibles |  |  |  |
| 6.4 | El diseño a imprimir cumple con las condiciones de tamaño del equipo |  |  |  |
| 6.5 | Se cuenta con las especificaciones de boquilla necesaria |  |  |  |
| **7.** | **Montaje de componentes electrónicos** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| 7.1 | Los equipos de soldadura adecuados se encuentran disponibles |  |  |  |
| 7.2 | Hay disponibilidad de insumos adecuados para el trabajo solicitado |  |  |  |
| 7.3 | Hay disponibilidad de equipos para las pruebas de continuidad eléctrica |  |  |  |
| **Aprobado**: SI NO | | | | |
| **Observaciones:** | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Responsable de la gestión técnica y administrativa | | | | |